

平成29年3月期(第15期) 決算説明会

平成29年5月16日株式会社ジーダット

平成29年3月期から単体になりました JEDAT®

平成27年6月30日に上海子会社を譲渡したことにより連結対象子会社が存在しなくなったため、平成29年3月期から当社単体となりましたが、本資料内で比較している平成28年3月期までの数値は、連結財務諸表の数値です。

連結

・・・・ 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年3月期 3月期 3月期 3月期 3月期

単体

平成29年 平成30年 3月期 3月期予想



1.平成29年3月期 決算概要

2.平成30年3月期 計画·業績予想

平成29年3月期のポイント



売上高:16.9億円(対前年比6.8%増)

営業利益:1.7億円(13.5%増)、経常利益:1.8億円(22.2%増)

ソリューション・ビジネスが大幅に拡大(41.1%増)

代理店製品を梃子に新規顧客層拡大(25.7%増)

次世代ブランドの自社開発製品の販売を開始

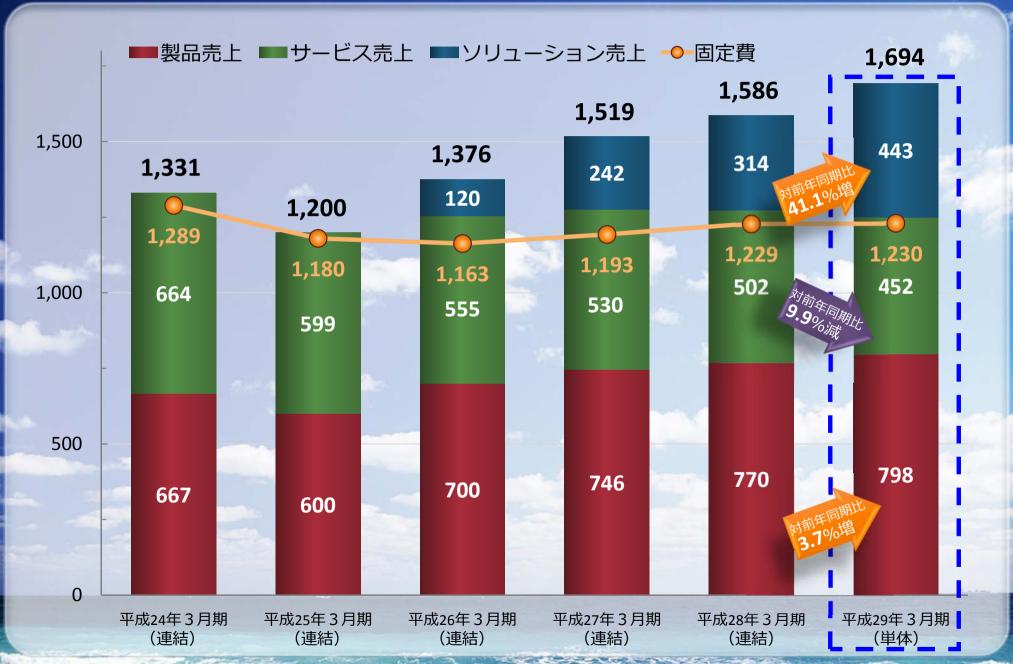
平成29年3月期業績概要 (連結・単体P/L)



		平成28年	F3月期	平成29年3月期			
		実績 (連結)	売上高比	実績 (単体)	売上高比	対前期比	
	売上高	1,586	100.0%	1,694	100.0%	+6.8%	
	売上総利益	1,098	69.2%	1,114	65.7%	+1.4%	
	販売費及び 一般管理費	944	59.5%	939	55.4%	△0.5%	
	営業利益	153	9.7%	174	10.3%	+13.5%	
	経常利益	153	9.7%	187	11.0%	+22.2%	
	当期純利益	112	7.1%	178	10.5%	+59.2%	
	親会社株主に帰属する当期純利益	97	6.1%				

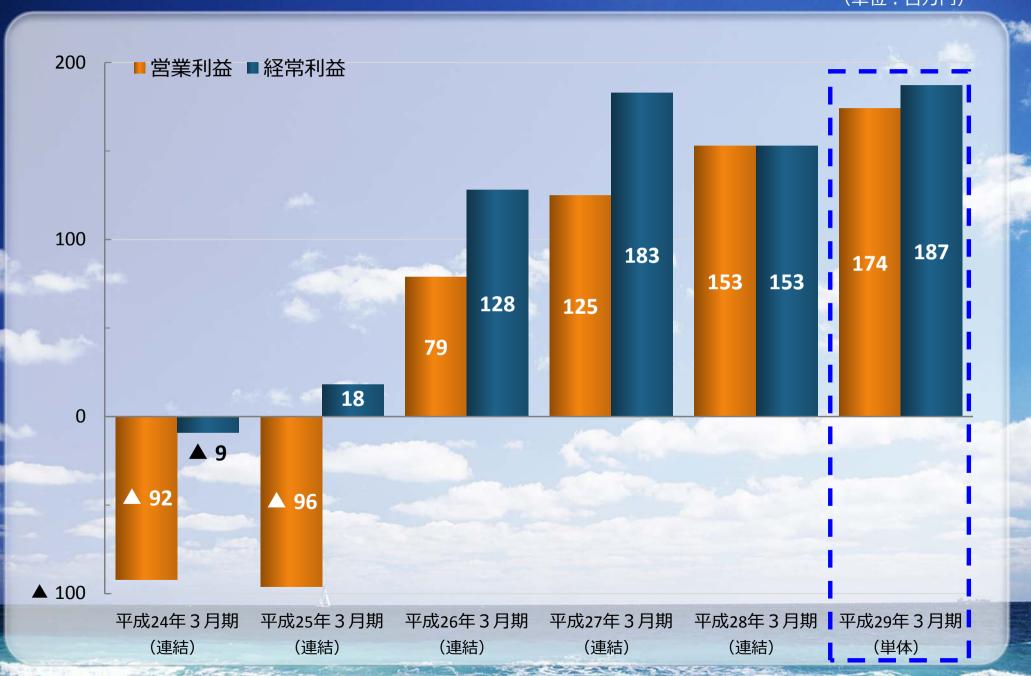
売上高・固定費の推移





利益の推移





市場別売上高(半導体/FPD)





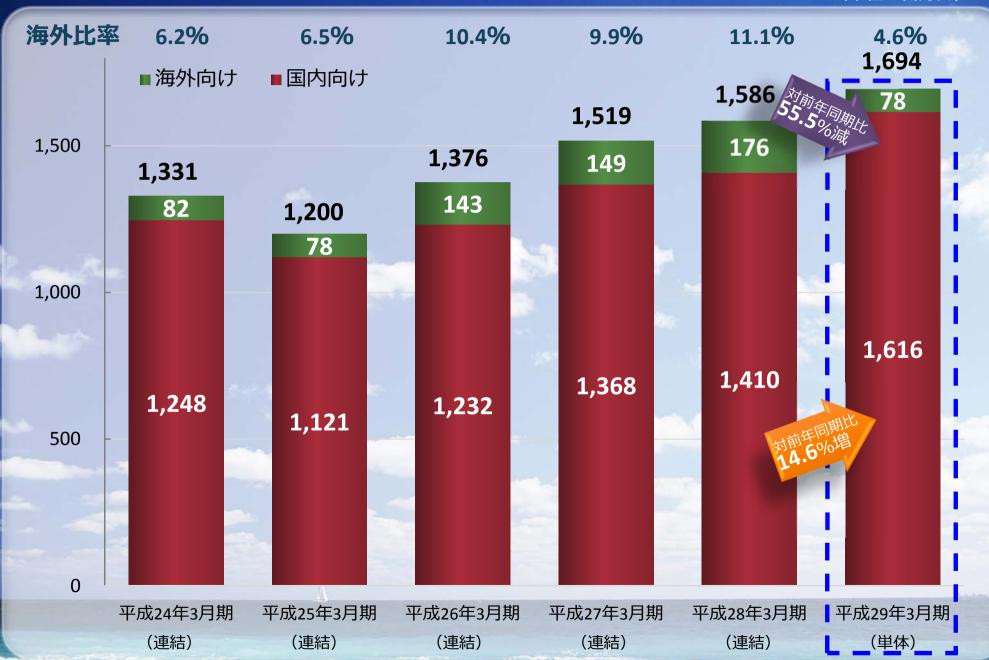
製品区分別売上高(自社開発/代理販売)





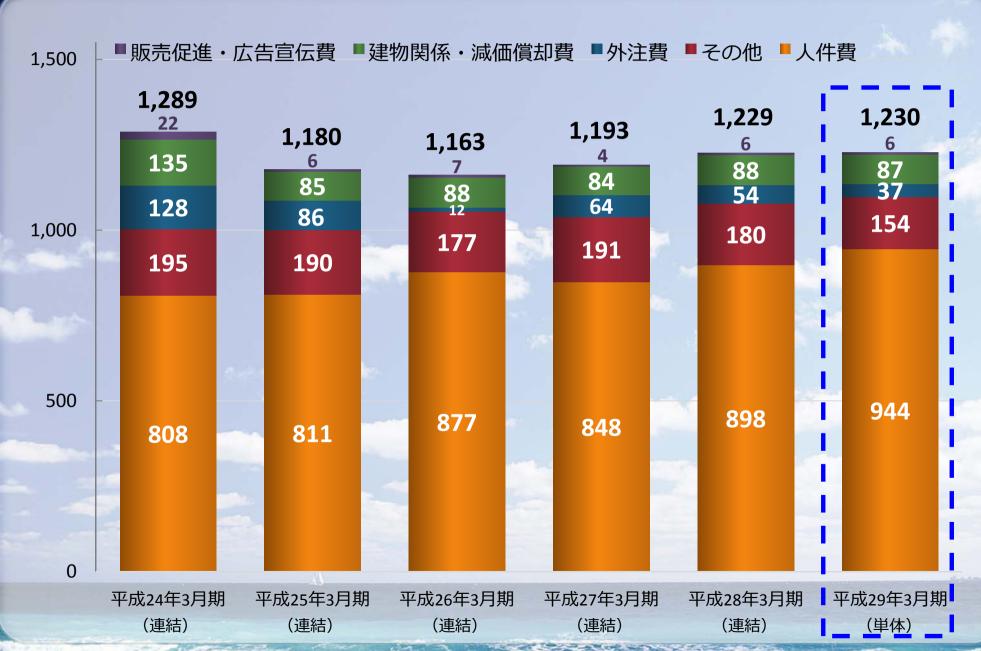
販売先別売上高(国内/海外)





固定費内訳





連結貸借対照表



	平成28年 3月期末	平成29年 3月期末	差異		平成28年 3月期末	平成29年 3月期末	差異
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産	2,597	2,909	312	I 流動負債	330	501	171
1 現金及び預金	1,952	2,465	513	1 買掛金	27	42	15
2 受取手形及び売掛金	212	207	Δ5	2 未払法人税等	8	33	25
3 電子記録債権	22	113	91	3 賞与引当金	86	91	5
4 有価証券	300	0	△300	4 その他	208	333	124
5 たな卸資産	3	15	11	負債合計	330	501	171
6 繰延税金資産	24	36	12	(純資産の部)			
7 その他	82	70	△11	I 株主資本	2,539	2,688	149
Ⅱ 固定資産	273	282	9	1 資本金	760	760	a., -
1 有形固定資産	17	15	Δ2	2 資本剰余金	890	890	
2 無形固定資産	15	10	Δ5	3 利益剰余金	921	1,071	149
3 投資その他の資産合計	240	256	16	4 自己株式	△32	△32	0
投資有価証券	222	222	0	Ⅱ 評価・換算差額等	_	_	
繰延税金資産	_	9	9	Ⅲ 新株予約権	1	1	Δ0
その他	18	24	6	純資産合計	2,540	2,690	149
資産合計	2,870	3,191	321	負債純資産合計	2,870	3,191	321

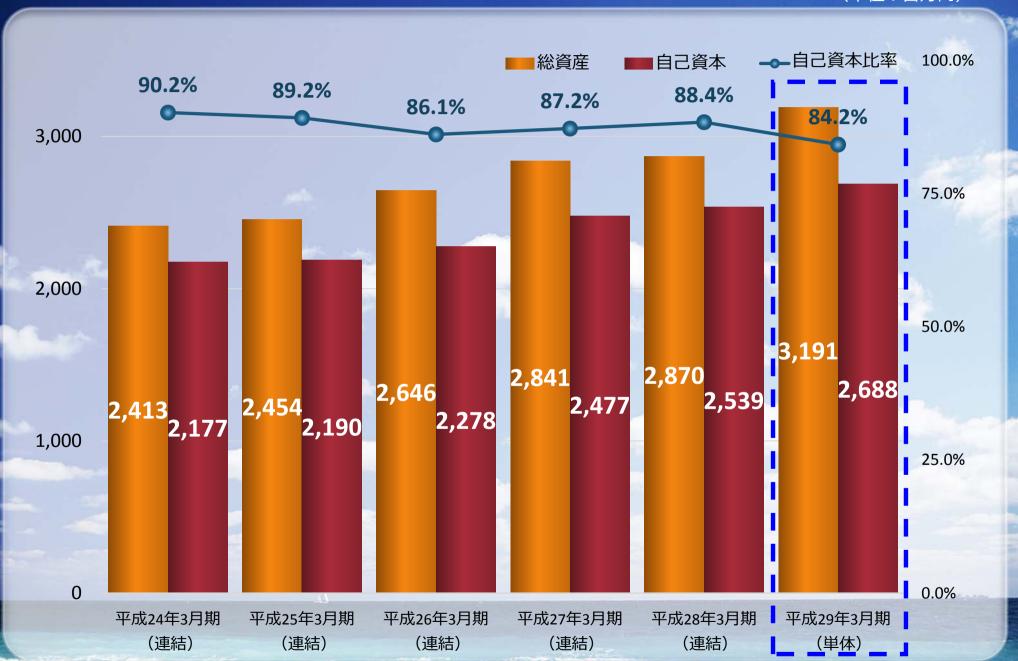
キャッシュフロー計算書



	平成29年3月期末
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	255
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	286
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	△28
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増減額	513
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,024
Ⅷ現金及び現金同等物の期末残高	1,537

総資産・自己資本





トピックス



- ◆新主力製品をリリース
 - ▶6月 「SX-Meister」 Ver.1.0.0をリリース
 - ▶12月「SX-Meister」Ver.2.0.0をリリース
- →プライベートセミナーを開催
 - ▶「SX-Meister」のロードマップを発表
 - ▶強力な代理販売品を紹介
- ◆熊本事業所がISO認証を取得
 - ▶半導体設計の熊本事業所がISO9001を取得
- ◆東北大とIoT向け電子部品設計に関して提携
 - ▶マイクロシステム融合研究開発センターとMEMS向け デバイス設計システムの構築に関して提携





1.平成29年3月期決算概要

2.平成30年3月期 計画・業績予想

平成30年3月期のポイント



売上高:19.5億円(対前年比15.0%増)

営業利益:1.5億円(対前年比14.1%減)

次期主力製品の本格的な販売活動を開始

海外向け販売体制を増強

ソリューション・ビジネスを更に拡大

平成30年3月期業績概要



	平成29年	F3月期	平成30年3月期			
	実績	売上高比	計画	売上高比	対前期比	
売上高	1,694	100.0%	1,950	100.0%	+15.0%	
売上総利益	1,114	65.7%	1,237	63.5%	+11.1%	
販売費及び 一般管理費	939	55.4%	1,087	55.8%	+15.8%	
営業利益	174	10.3%	150	7.7%	△14.1%	
経常利益	187	11.0%	150	7.7%	△19.9%	
当期純利益	178	10.5%	100	5.1%	△44.0%	

電子部品業界の状況



- ◆全般
 - ▶市場は成長中 スマホ、自動車、IoTが牽引
- →半導体
 - >世界市場は成長中+業界再編も継続中
 - >国内でも主要企業間の業界再編が未だ途上
 - ▶国内のファブレス・IPベンダの活動が拡大
 - ▶国内で設計アウトソーシング需要がひっ迫
- **◆FPD**
 - ▶異形パネル·有機ELパネル開発が加速
 - >中国では大型パネルへの巨額投資が継続中

課題と施策(1)



- →製品企画力/開発力/販売力の増強
 - ▶新主力製品の開発に注力
 - ●開発者を増員し「SX-Meister」の開発を更に加速
 - ●高競争力製品(解析・検証・自動設計)の開発力強化
 - ●品質向上施策の一環として、ISO9001取得へ始動
 - ▶販促活動の強化
 - ●プライベートセミナーを主軸に、年間を通して複数の 展示会および学会等への出展を企画
- ◆海外向け製品販売力の強化
 - ▶半導体市場の開拓活動の開始
 - ●重点販売国を設定し、販促リソースを集中
 - ▶解析・検証系ツールを新たに投入
 - ●米国、台湾

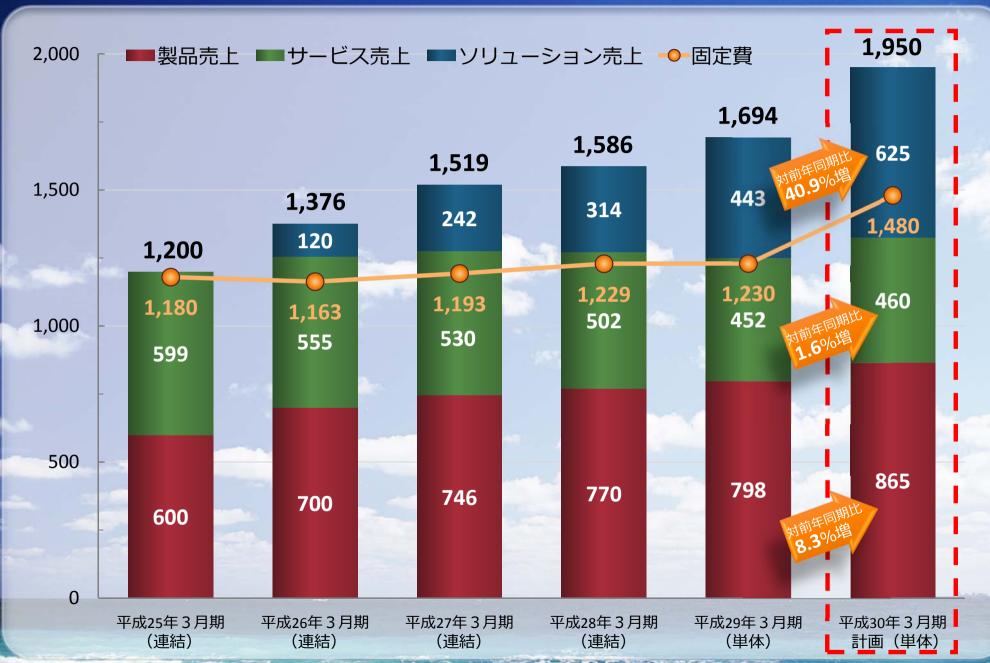
課題と施策(2)



- ◆ソリューション・ビジネスの拡大
 - ン半導体設計受託事業の拡大
 - ●熊本事業所の半導体設計者を更に増員
 - ●「ターン・キー」ビジネスの模索
 - ▶EDAアウトソーシング事業の拡販
 - ●社内外のリソースを結集し、着実な立上げを実施
- ◆新分野ビジネスの始動
 - ►センサ関連・再生可能エネルギー等の分野 に向けたマーケティング活動を継続
- ◆人員増強に対応した拠点の移動
 - >本社の移動
 - ▶熊本事業所の移動

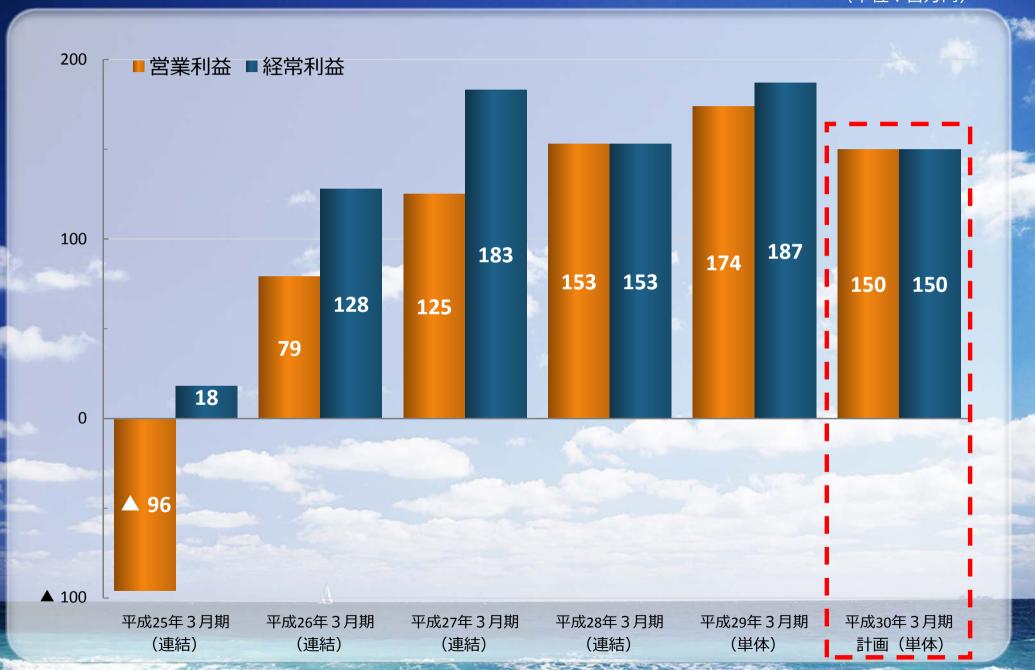
売上高・固定費の推移





利益の推移





市場別売上高(半導体/FPD)





販売先別売上高(国内/海外)





製品区分別売上高(自社開発/代理販売)







ご清聴ありがとうございました